

## 深圳市领先半导体科技产业股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

深圳市领先半导体科技产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：

### 一、情况概述

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年末母公司未分配利润为-223,458,383.77元，超过实收股本152,709,710元的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司未弥补亏损金额达实收股本总额三分之一时，需提交公司股东会审议。

### 二、导致亏损的原因

（1）子公司至正新材料受行业竞争等因素影响已连续亏损，本报告期置出该子公司产生了较大亏损；

（2）公司于2025年度完成了通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式直接及间接取得目标公司AAMI之99.97%股权并置出上市公司全资子公司至正新材料100%股权，自2025年11月30日起AAMI纳入合并报表，至正新材料不再纳入合并报表。2025年度因重大资产重组产生中介费，导致相关费用增加；

（3）子公司苏州桔云经营亏损，对苏州桔云的长期股权投资计提了减值损失。

### 三、采取的应对措施

公司将坚定聚焦半导体引线框架核心主业，坚持稳健经营、提质增效，依托控股子公司AAMI的境内外产业布局与行业积淀，充分发挥境内外生产基地、

海外客户资源及全球化运营优势，统筹产线协同互补与高效运营，强化生产全流程精细化管理，严控产品质量与生产成本，持续提升产线运营效率与资产使用效率；同步推进产品迭代与工艺创新，紧盯下游市场需求与技术趋势，深化与全球头部半导体 IDM 厂商、封测企业的战略合作，稳固境外核心市场份额，优化产品结构及订单质量，全力做精做强主业。公司将稳步推进滁州 AMA 工厂产能释放，依托其先进产线与自动化优势，进一步完善境内外产品与产能布局。

同时公司将持续强化研发创新，聚焦高端引线框架产品，紧跟先进封装技术趋势，针对汽车电子、算力芯片、工业等领域的高密度、高脚位、薄型化、小型化需求加快技术攻关与新品产业化，完善知识产权布局，推动产品结构向高端化升级，巩固行业技术领先地位。此外，公司将紧扣全球化发展需求，面向全球引进行业高端技术、管理及运营人才，健全专业化人才梯队，完善市场化薪酬激励与绩效考核体系，稳定核心骨干队伍，为公司经营状况持续改善及高质量长远发展提供坚实支撑。

特此公告。

深圳市领先半导体科技产业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日